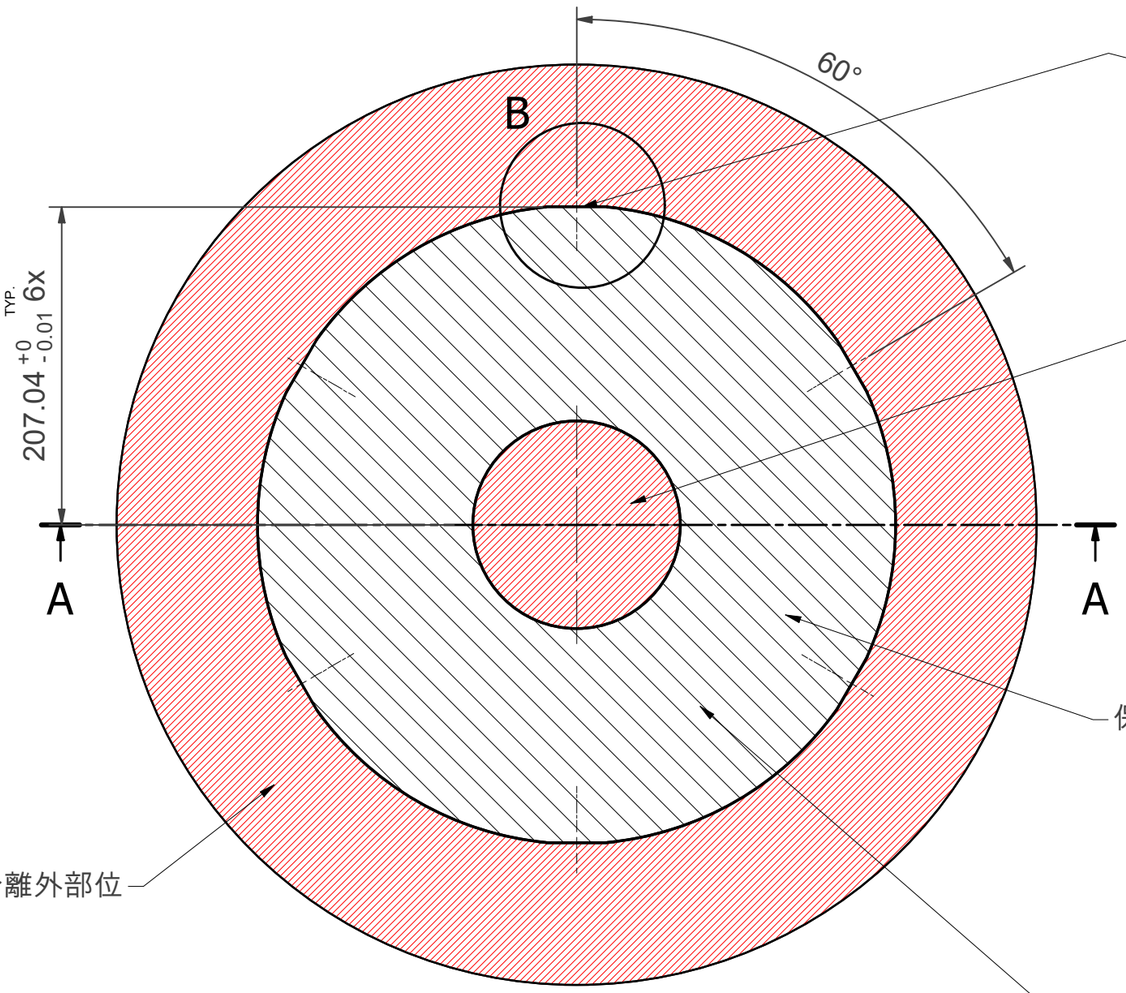
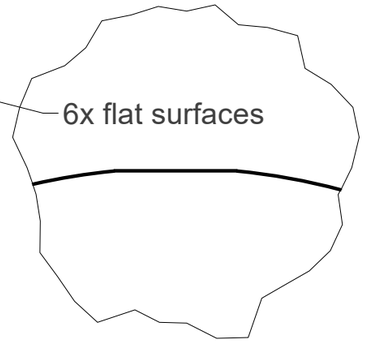
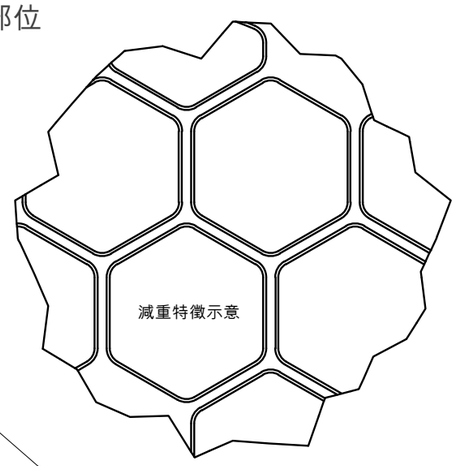
工業技術研究院機械工業研究所智慧財產權請勿複製

B ( 1 : 2 )

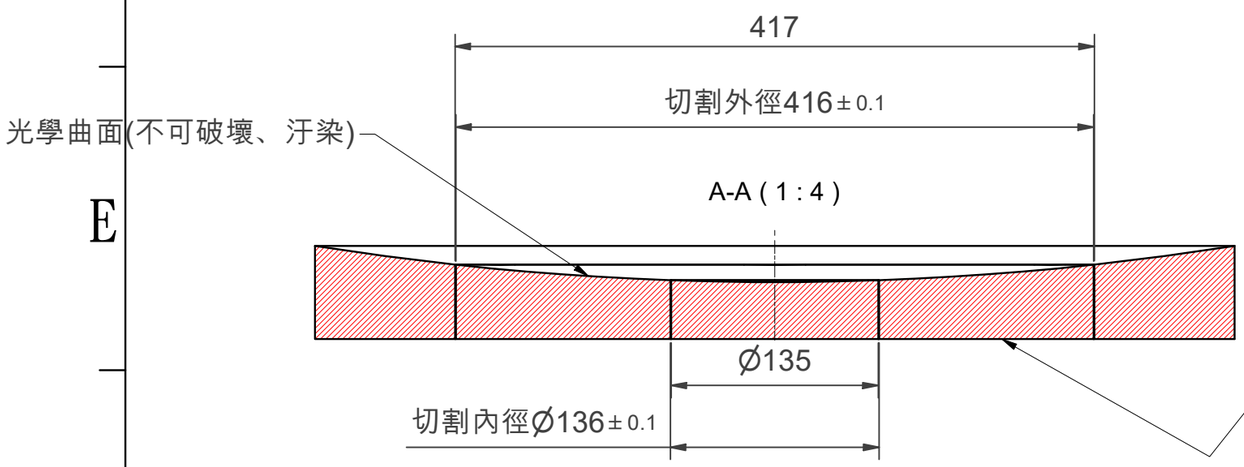



減重孔特徵分佈範圍

實物背後有減重孔特徵(勿破壞)




Note:
1.切割面不可有裂紋或崩角
2.光學面不可有刮痕及髒汙
3.減重孔為特徵不可有裂紋或崩角
4.切割委託，需含切割所需相關治具和配套
5.預切離部位單體需要完整，不可分割

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 孔與孔中心距公差 ±0.3<br>鑽孔, 沉頭孔公差 +0.25 −0.05<br>角度± 1° | 表面處理 | | 圖 名 | 416mml lens-內外輪廓切割 | |
| | 材 料 | CCZ | 檔 名 | 416mm space spherical lens-BFS_建已構特徵粗胚切割_2.idw | |
| | 計劃代號 | | 件 號 | | 圖紙號 |
| | 組合代號 | | 比 例 | 1:1 | 工件種類 一般機製 |
| 加工一般公差<br>>0 ±0.1<br>>6 ±0.2<br>>30 ±0.3<br>>120 ±0.5<br>>315 ±0.8<br>>1000 ±1.2 | 繪 圖 | 2026/11/12 | 李祐昇 | | |
| | 設 計 | 2022/5/13 | 李祐昇 | | |
| | 審 校 | | | | |
| | 核 准 | | | | |
| | | 日 期 | 姓 名 | | |

工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

B5-QF-001
84.4 ED2.0